制作過程

電子パーツを基板に配置する際、スルーホール実装と表面実装の二つの実装方法がある。スルーホール実装の場合、穴にパーツを差し込み、それを裏側で固定するのが通常の使用方法である。パーツを固定するため、削る面がパーツの裏側でなければならない。表面実装においては、穴は存在せず、パーツは全て削った面の上にそのまま半田で固定をする。また、表面実装とスルーホール実装のパーツは機能的には同じだが、表面実装のパーツのほうが格段に小さい場合が多い。そのため、スルーホール実装よりはるかに細かい操作を要求される。

この二つの実装方法を踏まえて、グラフィックデザインを用いた基板制作で最終的な外見を考慮する際、削った銅板の面を見せるか見せないかを必ず考慮する必要がある。両面銅板でない場合、銅板の裏側は〜〜であり、削った回路をあえて見せたいのか、銅板の裏側が表になる形でも大丈夫なのか、最終的なビジュアルの予想図によって判断しなければならない。

まず、一つ目のプロトタイプを制作した。

Johan von Knowがオープンソースとして公開している、簡易的なPCBミリングで作成可能なarduinoと同様の仕組みをもった「Nanino」のデータを利用し、そのパーツの配置を変え、理想の形の基板へ持って行こうと試みた。しかし、結果としては失敗に終わった。失敗した理由としては、Naninoがスルーホール実装を前提としたパーツを使っていたため、回路図のグラフィックにデータを合わせて基板を削ったところ、基板の向きが逆になってしまうという問題があり、求めていた基板デザインが左右反転してしまった。また、スルーホール型のパーツを使うと